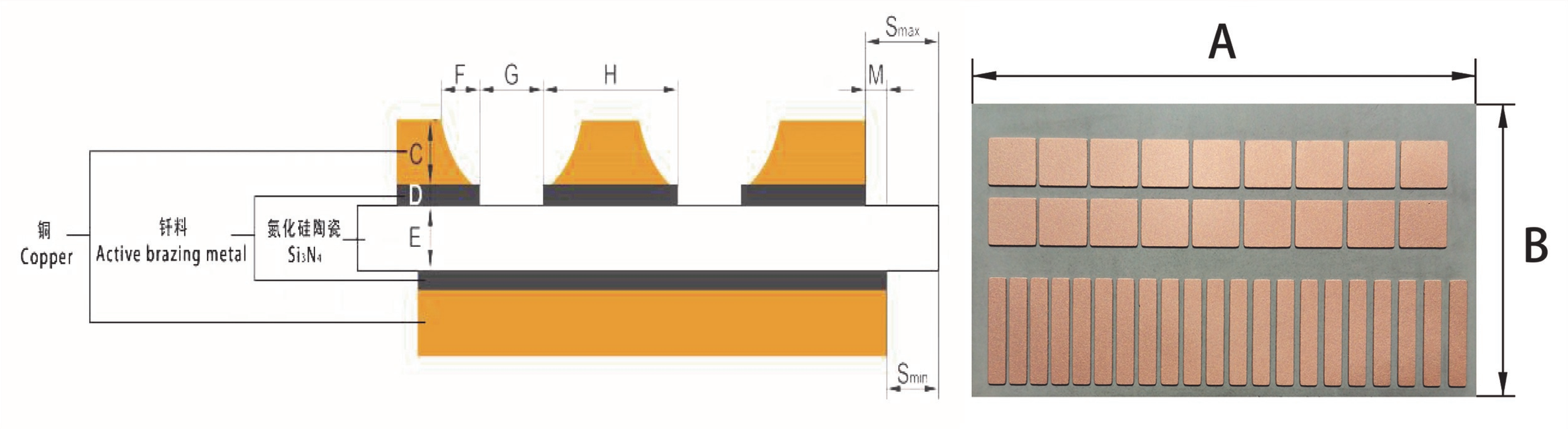
线路板标准设计规范 / Standard Design Rule of Circuit Substrate

尺寸单位/ Dimension Unit: mm

	陶瓷品类 / Ceramic Type	Silicon Nitride (Typ. Si_3N_4)	
A, B	陶瓷尺寸 / Ceramic Dimension	114.3*114.3	
	尺寸公差 / Dimension Tolerance	±1.1	
E	陶瓷厚度 / Ceramic Thickness	0.32	
	尺寸公差 / Dimension Tolerance	±0.05	
	电极材料 / Electrode Material	Cu-OFC（高纯无氧铜）	
C	原始铜箔厚度 / Original Copper Thickness	0.3±0.01	
F	侧蚀量 / Side Etching Dimension	≤ 1/2 C（C=Cu Thickness）	
G	线距 / Min. Insulation Gap	0.5±0.2（Braz1）	0.3±0.2（Braz2）
H	最小线宽 / Min. Copper Width	≥1.2	≥0.6
S	最小周边无铜区域 / Min. Copper Free Space	> 1/2G(G=Min. Insulation Gap, Sug. ≥0.5)	
M	双面电路错配 / Mismatch	≤0.2(Typ. 0.15)	
	表面粗糙度 / Roughness: Ra < 0.2		
	剥离强度 / Peeling Strength(@50mm/min @Cu-thickness 0.3mm): > 10 N/mm		
	陶瓷耐击穿电压/ Dielectric Strength of Ceramic: > 20 kV/mm		
	热冲击性/ Thermal Shock Test(@-50°C up to 150°C): > 2000 cycles		

* 以上数据为标准设计规则数据而非保证值。Values above are design rule and not guaranteed value.
请联系我们以获取其他参数。Please contact us for other parameters.